

中国・蘇州およびシンガポールでの先端半導体向け封止材の生産能力増強について

住友ベークライト株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:鍛冶屋 伸一)は、中国・蘇州およびシンガポールにおいて先端半導体パッケージ向け半導体封止材の生産能力を増強することをお知らせいたします。両拠点に、モールドアンダーフィル(MUF)用封止材「スミコン® EME」と圧縮成形用顆粒封止材「スミコン® EME Version GR」の生産ラインを新たに導入いたします。

増産投資の背景

生成 AI や通信衛星などに用いられる先端半導体の需要は、中国および東南アジアを中心に急速に拡大しており、半導体パッケージには、さらなる高密度化・薄型化・大型化への対応が求められています。

当社の MUF 用封止材は、微細な隙間への優れた充填性と低反り性を備え、はんだ接続部の充填とパッケージ全体の封止を一括して行うことで、高い信頼性と製造工程の効率化を両立します。

また、顆粒封止材は、優れた狭部充填性に加え、フィラーサイズ、樹脂粘度、顆粒粒度を最適に制御する技術により、大型パネルにおいても均一な成形性と低反り性を実現し、先端半導体の生産性向上に貢献します。こうした製品・技術の強みを生かし、拡大する需要に迅速かつ安定的に対応するため、中国・蘇州およびシンガポールの生産能力を増強します。



左:スミコン® EME Version GR 右:MUF 用スミコン® EME

増産投資の内容

(1)蘇州住友電木有限公司(中国・蘇州)

2024 年に竣工した新工場の敷地内に建屋を増築し、MUF 用封止材および顆粒封止材の生産ラインを新たに導入します。生産開始は 2030 年度を予定しています。

(2)Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.(シンガポール)

既存工場建屋内に、MUF 用封止材および顆粒封止材の生産ラインを新たに導入します。生産開始は 2028 年度末を予定しています。

今回の増産投資により、MUF 用封止材の生産能力は現行の約 2 倍、顆粒封止材は約 3 倍に拡大する見込みです。さらに、10 月末に予定する京セラ株式会社からのケミカル事業譲受により、同社が有する MUF 用封止材と顆粒封止材の生産能力が加わります。これらにより、日本、中国、東南アジアを含む主要な先端半導体生産地域で、供給体制を一段と強化します。

当社グループは、増産投資と事業譲受を通じて、先端半導体向け封止材のグローバル供給体制を強化します。拡大する需要を着実に取り込み、事業成長と市場シェアの拡大につなげます。

蘇州住友電木有限公司概要

所在地: 中国江蘇省蘇州

設立年: 1997 年

敷地面積: 約 60,000 m²

主要製品: 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、
ダイボンディングペースト



Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.概要

所在地: Senoko South Road, Singapore

設立年: 1982 年

敷地面積: 約 22,500 m²

主要製品: 半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、
ダイボンディングペースト



本件のお問合せ先: 住友ベークライト株式会社情報通信材料営業本部

TEL: 03-5462-4015

https://inquiry.sumibe.co.jp/m/j_itmaterials_epoxy

このリリースに関するお問い合わせは
コーポレート・コミュニケーション部
広報担当まで

〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目5-8
天王洲パークサイドビル

TEL (03) 5462-4818
FAX (03) 5462-4876
E-MAIL info@sumibe.co.jp